

Wärmeleitpaste QC-WLP-25

Die QC-WLP25 ist eine Wärmeleitpaste auf Basis keramischer Bestandteile, die sich besonders für die Montage von Peltiermodulen, Thermogeneratoren, Hochleistungskühlkörpern, Heat Pipes oder auch Wasserkühlen eignet.

Mikroskopische Partikel aus Aluminiumoxid, Bornitrid und Zinkoxid in fünf verschiedenen Molekülstrukturen und Formen garantieren einen maximalen Partikelkontakt in der Paste und somit einen besseren Wärmetransport durch reine Feststoffleitung. Diese Kombination von Partikelgrößen und Werkstoffen ermöglicht eine deutlich bessere Performance als bei herkömmlichen, teilweise auf metallischen Inhaltstoffen basierende Pasten.

Die durchschnittliche Partikelgröße ist $< 0,38\mu\text{m}$.

Die QC-WLP-25 ist frei von Silikon, das Bindemittel ist eine Zusammensetzung von mehreren speziellen synthetischen Ölen, die eine Langzeitstabilität und überdurchschnittliche Performance garantieren.

Bei der initialen Inbetriebnahme wird die Viskosität der Paste durch die Erwärmung verringert und die nun flüssigere Paste füllt selbst mikroskopische Oberflächenrauheiten ganz aus und vertreibt schädliche Lufteinschlüsse. Durch die geringere Viskosität wird zudem der Spalt auf ein Minimum reduziert und der thermische Kontakt zwischen den Flächen verbessert. Über die nächsten 25-30 Betriebsstunden verfestigt sich die Paste langsam zu ihrer idealen Konsistenz. Durch diesen Prozess wird ein Auspumpen durch temperaturinduzierte Längenausdehnungen langfristig unterbunden.

QC-WLP-25 wurde speziell optimiert um Separation der Inhaltsstoffe und Tropfen oder Fließen zu verhindern. Sie ist elektrisch isolierend und nicht elektrisch kapazitiv.

Der Temperaturbereich reicht von -40°C bis 180°C , QC-WLP-25 kann einfach mit Isopropanol, Spiritus oder Waschbenzin entfernt werden. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem MSDS.

Eigenschaften	
Verpackungsinhalt	10g
Farbe	weiß
physikalisch	Sehr zähflüssig
Wärmeleitfähigkeit	4,2 W/mK
Einsatztemperaturen	-150°C bis 180°C